

公司代码：688126

公司简称：沪硅产业

上海硅产业集团股份有限公司
2020 年半年度报告摘要

重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第四节经营情况讨论与分析”。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 本半年度报告未经审计。

6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无

7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

一 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

适用 不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	沪硅产业	688126	不适用

公司存托凭证简况

适用 不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	李炜	王艳
办公地址	上海市长宁路865号5号楼4楼	上海市长宁路865号5号楼4楼
电话	021-52589038	021-52589038
电子信箱	pr@sh-nsig.com	pr@sh-nsig.com

2.2 公司主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,175,273.28	996,324.41	17.96
归属于上市公司股东的净资产	749,763.60	507,201.00	47.82
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	2,736.44	1,743.83	56.92
营业收入	85,427.37	65,446.24	30.53
归属于上市公司股东的净利润	-8,259.42	-7,496.87	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-15,269.96	-11,784.85	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.35	-1.76	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.039	-0.043	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.039	-0.043	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	7.58	5.90	增加1.68个百分点

2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)							74,618
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结的股份数量	
上海国盛(集团)有限公司	国有法人	22.86	567,000,000	567,000,000	567,000,000	无	0
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	22.86	567,000,000	567,000,000	567,000,000	无	0
上海嘉定工业区开发(集团)有限公司	国有法人	7.03	174,272,600	174,272,600	174,272,600	无	0
上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	6.53	162,000,000	162,000,000	162,000,000	无	0
上海新微科技集团有限公司	国有法人	6.53	162,000,000	162,000,000	162,000,000	无	0

上海新阳半导体材料股份有限公司	境内非国有法人	5.63	139,653,500	139,653,500	139,653,500	无	0
中保投资有限责任公司—中国保险投资基金（有限合伙）	其他	4.15	102,827,763	102,827,763	102,827,763	无	0
中国工商银行股份有限公司—诺安成长股票型证券投资基金	其他	1.43	35,471,104	0	0	无	0
建骐实业有限公司	境外法人	0.70	17,452,800	17,452,800	17,452,800	无	0
宁波联利中芯投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	0.56	14,009,400	14,009,400	14,009,400	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知无限售条件股东间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	/						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

适用 不适用

2.5 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

适用 不适用

2.6 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

2.7 未到期及逾期未兑付公司债情况

适用 不适用

二 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

半导体行业市场规模总体呈波动上升趋势，与宏观经济、下游应用需求以及自身产能库存等因素密切相关，行业整体处于周期波动、螺旋上升的趋势。半导体硅片市场基本上随半导体行业整体趋势同步波动。

2020年上半年，受新冠肺炎疫情及国际贸易和科技竞争环境扰动的影响，全球半导体行业受到较大冲击，但下游消费市场按行业不同受到的影响程度有所不同。市场调研机构 IDC 估计 2020年上半年手机出货量和去年同期相比下降约 18.2%；笔记本电脑、平板电脑等，受益于远程办公的需求，出货量相对平稳；医疗电子需求提升；全球汽车销量大幅下滑，汽车电子需求显著下滑。

公司作为半导体产业链上游的材料供应商，春节复工后因交通运输和人员往来受阻，公司部分原材料运输、机器设备安装进度等受到一定影响，但目前生产经营均已恢复正常。

公司 2020 年上半年主要经营情况分析如下：

1. 财务指标完成情况分析

截至 2020 年 6 月 30 日，公司的资产总额为 1,175,273.28 万元，较 2019 年底资产总额 996,324.41 万元增幅 17.96%；负债总额为 416,305.78 万元，较 2019 年底年负债总额 478,880.50 万元减少 13.07%；股东权益为 758,967.49 万元，较 2019 年底年股东权益 517,443.91 万元增幅 46.68%。公司总资产和股东权益的增长主要是公司上市募集资金增加所致。负债的减少主要是公司归还股东借款所致。

2020 年 1-6 月，公司实现营业收入为 85,427.37 万元，较上年同期增长 30.53%；归属于母公司股东净利润为-8,259.42 万元，较上年同期亏损增加 10.17%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为-15,269.96 万元，较上年同期亏损增加 29.57%。营业收入较上年同期增长 30.53%，主要系 2019 年 3 月底并购新傲科技，因此 2019 年同期中不包含新傲科技一季度的财务数据；同时子公司上海新昇 300mm 硅片的销量持续增加所致。公司利润同比下滑主要是由于一方面公司持续加大研发投入，同时存货跌价准备计提金额受市场价格影响有所增加所致。

2020 年上半年，公司经营活动产生的现金流量净额为 2,736.44 万元，较上年经营活动产生的现金流量净额 1,743.83 万元增幅为 56.92%。主要原因是由于 2019 年 3 月底并购新傲科技，因此 2019 年同期中不包含新傲科技一季度的财务数据所致。

2. 技术研发

公司继续推进国家重大科研项目及公司自研项目的研发工作，2020 年上半年研发支出 6,473.13 万元，研发投入总额占营业收入比例为 7.58%，较上年同期 5.90% 增加 1.68 个百分点。

公司研发支出与公司所处的发展阶段、承担的重大研发项目研发进度相一致。公司研发投入占销售收入的比重高于同行业上市公司平均值，并且公司研发投入并未受到盈利情况的影响，2020 年上半年研发支出仍然保持在较高水平。

3. 产能建设

子公司上海新昇正在进行募投项目即集成电路制造用 300mm 硅片技术研发与产业化二期项目的建设，300mm 硅片生产线产能从 2019 年的 15 万片/月进一步提高，虽然受疫情影响上半年设备安装有所延迟，但通过后续进度的加快，预计在 2020 年底达到 20 万片/月产能的计划保持不变。子公司 Okmetic、子公司新傲科技持续通过去瓶颈化和提高生产效率的方式，进一步提升产能。

4. 产品认证

公司 300mm 大硅片和 200mm 及以下半导体硅片（含 SOI 硅片）认证的产品数量持续增加。其中，300mm 硅片加速推进研发和产品认证工作，按项目进度要求继续推进《20-14nm 集成电路用 300mm 硅片成套技术开发与产业化》、《存储器用 300mm 无缺陷硅片研发与先进制造》等重大项目的研发和产业化进展，在拉晶、切磨抛等工艺环节取得进一步突破。20-14nm 技术节点的外延硅片和抛光硅片产品正在进行认证工作，针对 CIS 等应用开发的硅片产品也陆续通过或正在认证过程中。

5. 对外投资

报告期内，公司根据自身发展战略规划，新增三项对外投资，投资对象分别为：湖北三维半

导体集成制造创新中心有限责任公司，公司持股 4.31%；上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司，公司持股 5.88%；上海集成电路材料研究院有限公司，公司持股 25%。上述新增对外投资将进一步加强公司与上下游产业链的交流合作，整合国内集成电路产业创新资源，进一步巩固并深化与国内集成电路制造业龙头的合作研发关系，形成紧密合作的创新网络。上述新增对外投资也有利于公司硅片产品的联合研发、认证和销售，有利于公司拓展在集成电路材料环节持续耕耘的深度和广度。

上海硅产业集团于 2020 年 6 月完成对上海新昇持有的上海新昇 1.5% 股权的收购，使上海新昇成为公司全资子公司，有利于上海新昇的进一步发展和公司 300mm 硅片业务的进一步拓展。

公司子公司上海新昇于 2020 年 6 月以自有资金认缴出资人民币 20,000 万元，作为有限合伙人参与投资青岛聚源芯星股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“聚源芯星”）。聚源芯星认缴规模为人民币 230,500 万元，并作为战略投资者认购中芯国际在科创板首次公开发行的股票。公司以间接的战略投资者身份参与对中芯国际首发股票的认购，有利于进一步加强与中芯国际的业务合作。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

2020 年 1 月 1 日，公司执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号收入》，具体请参考第十节财务报告，附注五（44）。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

适用 不适用